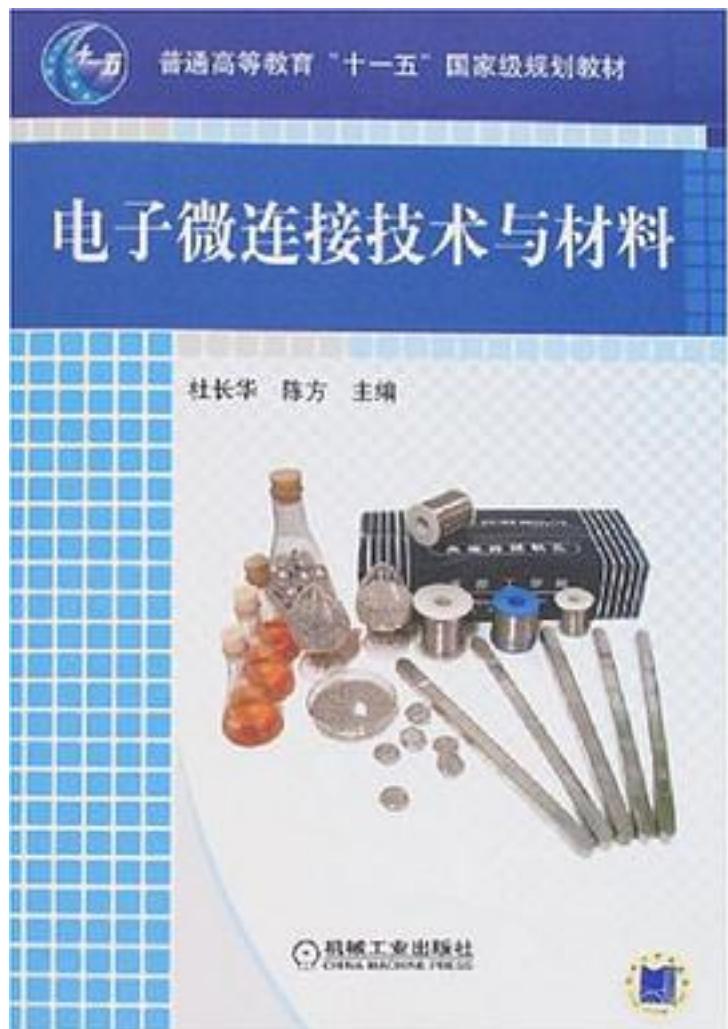


# 电子微连接技术与材料



[电子微连接技术与材料 下载链接1](#)

著者:杜长华

出版者:机械工业

出版时间:2008-2

装帧:

isbn:9787111231929

《普通高等教育"十一五"国家级规划教材 · 电子微连接技术与材料》是普通高等教育 “

“十一五”国家级规划教材。《普通高等教育“十一五”国家级规划教材·电子微连接技术与材料》对现代电子微连接技术和材料作了全面、系统的介绍，全书共分8章，主要内容包括电子微连接的原理、方法及工艺，微连接材料及试验方法，现代微电子封装技术、芯片互连技术与材料等。

《普通高等教育“十一五”国家级规划教材·电子微连接技术与材料》以微连接技术为主线，突出微连接技术与材料的结合，注重分析问题和解决问题的思路，理论联系实际。书中大量收录了国内外近年来在电子微连接技术领域取得的最新成果以及工程应用实例，立足培养学生在工程方面的技术和科研能力，对教学、科研和生产均具有重要的实用价值。

作者介绍:

目录:

[电子微连接技术与材料 下载链接1](#)

标签

技术

评论

[电子微连接技术与材料 下载链接1](#)

书评

[电子微连接技术与材料 下载链接1](#)